

1. ロジャース 汎用タイプ高周波基板材料

RO3000™ シリーズ

RO3000 シリーズは PTFE/セラミックのコンポジット基材です。誘電率は、3.0, 6.15, 10.2 の 3 タイプがあり、低損失が要求される民生用途に最適です。RO3200 シリーズはガラスクロスの入ったタイプで、機械的強度に優れます。

- ・高い周波数帯域においても誘電率、誘電正接が安定しております。
- ・環境温湿度に対しても、寸法安定性、熱膨張係数 CTE に優れます。

RO4000™ シリーズ

RO4000 シリーズは熱硬化性樹脂/セラミックフィラー・ガラスクロスコンポジット基材です。加工性はガラスエポキシ基材に近く、電気特性は PTFE 基板並みです。誘電率は 3.38, 3.48, 6.15 の 3 タイプがあります。プリプレグとして、RO4400 シリーズを用意しております。

- ・ガラスエポキシ基材の装置で加工ができます。
- ・温度変化に対して誘電率が安定しております。
- ・環境温湿度に対しても寸法安定性、熱膨張係数 CTE に優れ、吸水性も低い。
- ・熱伝導性が高い。

ターゲット用途

- + 基地局用パワーアンプ
- + 基地局用アンテナ、RFID アンテナ
- + サーバー・ルーター
- + 計測器
- + 衛星用コンバーター
- + チップパッケージ
- + 車載衝突防止レーダー
- + その他、準ミリ波、ミリ波帯域の用途など

2. ロジャース 高機能タイプ高周波基板材料

RT/duroid®5870, 5880

PTFE とマイクログラスファイバーをベースとした低誘電率、低損失のコンポジット基材になります。誘電率は 2.33, 2.20 の 2 タイプになります。

- ・誘電率のバラつきが無く、誘電正接も極めて低く、広い範囲の周波数帯で一定した特性を持ちます。
- ・耐薬品性も高く、吸水性も低い
- ・アルミ、真鍮、銅プレートの裏打ちをした製品としても供給可能です。

RT/duroid®6000 シリーズ

RT/duroid6000 シリーズは PTFE/セラミックフィラーからなるコンポジット基材になります。誘電率は 2.94, 3.50, 6.15, 10.2 の 4 タイプがあります。

- ・誘電率のバラつきが無く、誘電正接も極めて低く、広い範囲の周波数帯で一定した特性を持ちます。
- ・熱膨張係数 CTE が低いため、スルーホール信頼性が高い。
- ・アルミ、真鍮、銅プレートの裏打ちをした製品としても供給可能です。

TMM™ シリーズ

TMM シリーズは、熱硬化性樹脂/セラミックフィラーからなるコンポジット基材になります。誘電率は 3.27, 4.50, 6.00, 9.20, 9.80 の 5 タイプがあります。

- ・広い範囲の温度変化に対して、誘電率の温度係数がアルミナ以上に安定しています。
- ・熱伝導率が PTFE ベース基板に対して高い。
- ・銅にマッチングした熱膨張係数により、スルーホールの信頼性が高い。
- ・機械的強度が強い。
- ・信頼性のあるワイヤーボンディングが可能です。
- ・ハロゲンフリーの基材です。

ターゲット用途

- + アンテナ、レーダーシステム、パワーアンプなどの航空宇宙、衛星通信、防衛用途
- + 高周波測定装置
- + フィルター、カップラー用途
- + その他、準ミリ波、ミリ波帯域の用途など

3. ロジャース フレキタイプの特種基材

ULTRALAM®3000

LCP(液晶ポリマー)で誘電率 2.9、低損失および吸水率に優れた基材になります。

SYRON™ 7000 シリーズ および XT/duroid™ 8000 シリーズ

熱可塑性樹脂タイプの基材で誘電率 3.23 - 3.4 になります。高耐熱性、高い耐薬品性、高電気絶縁性を併せ持つ高周波基材になります。

厚みは 0.05 - 0.1mm の薄いタイプの基板材料になります。

ターゲット用途

- + 車載、航空、宇宙用途の基板
- + RF アンテナ、センサー基板
- + 半導体用バーンインポート
- + 雷、オイル、薬品に対する保護フィルム

問い合わせ先

ロジャースジャパンインク

103-0021

東京都中央区日本橋本石町3-2-7 常盤ビル

TEL : 03 - 5200 - 2700

FAX : 03 - 5200 - 0571

E-mail : rjics@rogerscorporation.com